# (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-102259

(43)公開日 平成10年(1998) 4月21日

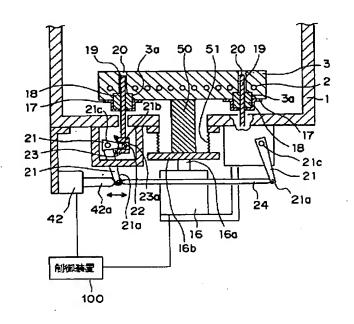
(51) Int. Cl. <sup>6</sup> C23C 16/44	識別記号		F I C23C 16/44	F I C23C 16/44		н	
						F	
C23F 4/00			C23F 4/00	)		Z	
G02F 1/1333	500		G02F 1/13	333	500		
H01L 21/3065			HO1L 21/68	3		N	
		審査請求	未請求 請求	項の数4	OL	(全7頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	<b>特願平8-258504</b>		(71)出願人	00000582	21		
(,				松下電器	器産業株式会社		
(22)出願日	平成8年(1996)9月30日			大阪府門	真市大	字門真1006都	<b>昏地</b>
			(72)発明者	滝澤 貴	博		
				大阪府門	真市大	字門真1006都	番地 松下電器
				産業株式	会社内		
			(72)発明者	石田 敏	道		
		•				字門真1006都	番地 松下電器
				産業株式			
			(72)発明者				
							番地 松下電器
			•	産業株式			
			(74)代理人	弁理士	青山	葆(外24	
					最終頁に続く		

## (54) 【発明の名称】基板突き上げ機構

### (57)【要約】

【課題】 本発明は、髙温に加熱される電極において、 処理中に電極上で基板裏面とピンとピン穴で形成される すき間を最小にするとともに、電極が膨張しても確実に 動作し、放電の回り込みを防止する基板突き上げ機構を 提供する。

【解決手段】 ピン昇降ガイド18を電極3の裏面に設けることでピン19とピン穴20とピン昇降ガイド18を同心に設けるとともに、ピン19とピン昇降手段42との連結部においてピン19の昇降方向のみを拘束することで基板裏面とピン19とピン穴20の隙間を最小にする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 真空状態で処理ガスのプラズマによって 基板 (10) を処理する反応室(1) 内で、上記基板を 載置しかつ基板加熱手段(2)と電極昇降手段(16) を有した電極 (3) に対して上記基板を昇降させる基板 突き上げ機構において、

上記電極の貫通穴(20)を貫通する基板突き上げ用ピ ン(19)と、

上記電極に備えられ、かつ、貫通穴を有して該貫通穴内 で上記ピンが同心状態で昇降して上記ピンの昇降を案内 10 するピン昇降ガイド(18)と、

上記ピンに対して、上記ピンの昇降方向には一体的に移 動する一方、上記基板加熱手段により上記電極が加熱さ れるときの上記電極の熱膨張に応じて上記昇降方向とは 異なる方向には移動可能に連結された駆動部(23,2 2) を昇降駆動して上記ピンを昇降駆動させるピン昇降 駆動機構(21,42)と、

を備えるようにしたことを特徴とする基板突き上げ機

【請求項2】 上記ピン昇降駆動機構は、ピン昇降手段 20 (42) と、該ピン昇降手段の駆動により揺動軸(21 c)回りに揺動されるピン昇降用レバー(21)とを備 えるとともに、上記駆動部は、上記ピン昇降用レバーの 一端に回転可能に備えられたローラ(22)を備え、 上記ピンの下端に該ピンの上記昇降方向とは直交する方 向に延びた溝(23d)を有し、上記ピン昇降駆動機構 の上記駆動部のローラを上記溝内に、上記基板加熱手段 により上記電極が加熱されるときの上記電極の熱膨張に 応じて上記昇降方向とは直交する方向沿いに移動可能 に、嵌合して、

上記ピン昇降手段の駆動により上記ピン昇降用レバーが 揺動されて上記ローラが昇降し、該ローラに嵌合された 上記溝を有する上記ピンが昇降するようにした請求項1 に記載の基板突き上げ機構。

【請求項3】 上記電極を昇降させるとともに、該電極 の昇降動作と同期して上記ピンを昇降させる電極昇降機 構(16,26,27,100)をさらに備えるように した請求項1又は2に記載の基板突き上げ機構。

【請求項4】 上記電極を昇降させるとともに、該電極 の昇降動作と同期して上記ピンを昇降させる電極昇降機 40 構(16,26,27)をさらに備え、

上記電極昇降機構は、上記電極を昇降させる電極昇降手 段(16)と、上記電極昇降手段の上記電極の昇降の際 及び上記ピン昇降機構の昇降駆動の際に支点回りに回転 させて上記ピン昇降用レバーを揺動させるレバー(2 6) とを備えるようにした請求項2に記載の基板突き上

げ機構。 【発明の詳細な説明】

[0001]

等の比較的大型の基板に対して、プラズマによる薄膜形 成やエッチングを行う製造装置に関するものである。 [0002]

【従来の技術】近年、半導体や液晶パネルの製造装置に おいては、基板の大型化のためにバッチ処理から枚葉処 理へとその生産形態が移行してきている。上記枚葉処理 では、基板を一枚ずつ反応容器内で処理するために、処 理する度毎に電極上に未処理の基板を搬送手段により反 応容器に対して搬入し、処理済みの基板を反応容器から 搬出する必要がある。そこで、従来から基板の反応容器 に対する搬入、搬出のために、電極の下側からピンによ り基板を突き上げる機構が多く用いられてきている。以 下に、従来の基板突き上げ機構について、液晶用プラズ マCVD装置を例に取り、図4を用いて説明する。所定 の真空度まで排気されたチャンバ1内に昇降可能でヒー 夕2を有し、所定温度(例えば400℃まで)加熱され た下部電極3と、該下部電極3と対向して上部電極4と がチャンパ1内に設置されている。上記上部電極4は、 処理ガスの導入パイプ5と整合器6と髙周波電源7が接 続され、絶縁体8を介して、チャンパ上蓋9に取り付け られている。基板10は、搬送アーム11によって、予 め下降している上記下部電極3と上記上部電極4の間に 搬入される。その後、ピン昇降シリンダ12の上昇駆動 により、そのピンテーブル13上に固定された4本のピ ン14が上記下部電極3に設けられたピン穴15を貫通 する形で、上記ピン14により上記基板10が上記搬送 アーム11の水平移動位置よりも高い位置まで持ち上げ られる。この状態で、上記搬送アーム11を上記下部電 極3の上方から後退(図4においては右方向に退避移 動)させ、その後、ピン昇降シリンダ12の下降駆動に 30 よりピン14の先端を下部電極3の表面より下降させる ことによって、基板10は下部電極3に載置され、ヒー **夕2により加熱される。下部電極3は処理を行うため基** 板10を載置したまま電極昇降シリンダ16によって所 定の位置まで上昇する。このとき、ピン14は下降した ままである。上部電極4の導入パイプ5を介してSiH 、NH。、N2、H2等の処理ガスを供給しながら高 周波電源7から整合器6を介して上部電極4に髙周波電 力を印加すると、上部電極4と下部電極3との間でプラ ズマが発生し、基板10の表面に例えば窒化膜等が形成 される。処理の終わった基板10は、電極昇降シリンダ 16により下部電極3に載置されたまま元の位置まで下 降する。その後、ピン昇降シリンダ12の上昇駆動によ りピン14によって搬送アーム11の水平移動位置より も高い位置まで基板10が持ち上げられ、搬送アーム1 1に受け渡される。このようにして処理が終了する。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、半導体や液 晶パネルの製造における基板を加熱し処理する工程にお 【発明の属する技術分野】本発明は、液晶用ガラス基板 50 いて、例えばアルミ製の電極では特に熱膨張が大きいた め、従来の基板突き上げ機構ではピンとピン穴の相対位置がずれることになり、電極の膨張を見込んで例えば直径5mmのピンに対し、ピンの周囲に3mm程度のすき間を形成するように大きめのピン穴を設ける必要があった。そのため、ピン穴へ放電の入り込む空間が増え、基板裏面に放電痕を発生するという欠点を有していた。本発明は、高温に加熱される電極において、処理中に電極上で基板裏面とピンとピン穴で形成されるすき間を最小にするとともに、電極が膨張しても確実に動作し、放電の回り込みを防止する基板突き上げ機構を提供すること 10を目的とする。

## [0004]

【課題を解決するための手段及びその作用効果】本発明 は、上記目的を達成するため、ピン昇降ガイドを電極裏 面に設けることでピンとピン穴とピン昇降ガイドを同心 に設けるとともに、ピンとピン昇降手段との連結部にお いてピンの昇降方向のみを拘束することで基板裏面とピ ンとピン穴の隙間を最小にするようにしたものである。 具体的には、本発明の第1態様によれば、真空状態で処 理ガスのプラズマによって基板を処理する反応室内で、 上記基板を載置しかつ基板加熱手段と電極昇降手段を有 した電極に対して上記基板を昇降させる基板突き上げ機 構において、上記電極の貫通穴を貫通する基板突き上げ 用ピンと、上記電極に備えられ、かつ、貫通穴を有して 該貫通穴内で上記ピンが同心状態で昇降して上記ピンの 昇降を案内するピン昇降ガイドと、上記ピンに対して、 上記ピンの昇降方向には一体的に移動する一方、上記基 板加熱手段により上記電極が加熱されるときの上記電極 の熱膨張に応じて上記昇降方向とは異なる方向には移動 可能に連結された駆動部を昇降駆動して上記ピンを昇降 駆動させるピン昇降駆動機構と、を備えるように構成し ている。

【0005】また、本発明の第2態様によれば、第1態様において、上記ピン昇降駆動機構は、ピン昇降手段と、該ピン昇降手段の駆動により揺動軸回りに揺動されるピン昇降用レバーとを備えるとともに、上記駆動部は、上記ピン昇降用レバーの一端に回転可能に備えられたローラを備え、上記ピンの下端に該ピンの上記昇降方向とは直交する方向に延びた溝を有し、上記ピン昇降駆動機構の上記駆動部のローラを上記溝内に、上記基板加熱手段により上記電極が加熱されるときの上記電極の熱膨張に応じて上記昇降方向とは直交する方向沿いに移動可能に、嵌合して、上記ピン昇降手段の駆動により上記ピン昇降用レバーが揺動されて上記ローラが昇降し、該ローラに嵌合された上記溝を有する上記ピンが昇降するように構成することもできる。

【0006】また、本発明の第3態様によれば、第1, 2態様において、上記電極を昇降させるとともに、該電 極の昇降動作と同期して上記ピンを昇降させる電極昇降 機構をさらに備えるように構成することもできる。 【0007】また、本発明の第4態様によれば、第2態様において、上記電極を昇降させるとともに、該電極の昇降動作と同期して上記ピンを昇降させる電極昇降機構をさらに備え、上記電極昇降機構は、上記電極を昇降させる電極昇降手段と、上記電極昇降手段の上記電極の昇降の際及び上記ピン昇降機構の昇降駆動の際に支点回りに回転させて上記ピン昇降用レバーを揺動させるレバーとを備えるように構成することもできる。

[0008] 本発明の上記各態様によれば、電極の温度を室温から高温まで変化させても、上記電極と上記ピンと上記ガイドは上記電極の熱膨張に応じて一体的に移動することができ、熱膨張によってピンとピン穴の相対位置は変化しないため、基板突き上げ機構が確実に動作できて、ピン近傍での放電の回り込みを防止し、商品の品質を向上させることができる。

### [0009]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、ピンとピン昇降手段との連結部においてピンの昇降方向のみ拘束し他の方向には拘束しないようにすることにより、例え ば電極の温度を室温から高温まで変化させて電極が熱膨張したときピンは電極と一体的に昇降方向とは異なる方向に移動することができる。よって、熱膨張によってピンとピン穴の相対位置は変化しないため、基板突き上げ機構が確実に動作できるとともに、電極上面に載置された基板とピンとピン穴のすき間を小さくすることができ、ピン近傍での放電の回り込みを防止し、製品の品質を向上させることができる。

#### [0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の種々の実施の形態について、図1~3を用いて説明する。本発明の第1実施形態にかかる基板突き上げ機構は、下部電極3の裏面に複数のピン昇降ガイド18を設け、個々に基板突き上げ用ピン19とピン穴20とピン昇降ガイド18を同心に設け、ピン19とピン昇降手段との連結部においてピン19の昇降方向のみを拘束したものであり、ピン19とピン昇降ガイド18とが下部電極3の熱膨張に伴い一体となって移動できるようにしたものである。

【0011】図1は上記第1実施形態にかかる基板突き上げ機構を示しており、ピン昇降手段として揺動リンクを利用している。反応室の一例としてのチャンバ1内において、加熱手段としてヒータ2を内蔵しかつ電極昇降シリンダ16により昇降可能なアルミニウム製の下部電極3において、取付フランジ17により固定された円柱状のガイド18は、4本のピン19が同心状態でかつガイド18の貫通穴内を貫通して昇降するように嵌合されてピン19の昇降を案内する。焼き付き防止のため、例えばガイド18はセラミック、ピン19はニッケルという組み合わせで構成されるのが好ましい。下部電極3の各ピン穴20と同心に配置するために各ガイド18は、下部電極3に設けられた円形の座ぐり穴3aに嵌合され

20

40

ている。一例として、各ピン19と各ピン穴20とは 0. 1~0. 5mm程度のわずかな隙間で構成されてい る。レバー21は、ピン昇降シリンダ42による昇降動 作をチャンパ1内へ導入し、ピン19の昇降のための揺 動を行う。すなわち、ピン昇降シリンダ42のピストン 42aが図1において大略横方向沿いに往復移動するよ うにピン昇降シリンダ42がチャンバ1の下端に固定さ れ、そのピストン42aの先端には、大略L字状レバー 21の下端21aが枢着されている。レパー21は揺動 軸21cの回りに揺動可能に支持されている。レパー2 10 1の右端21bに回転自在に取り付けられたローラ22 は、ピン19の下端に取り付けられたポス23に形成さ れた溝23aの中をレパー21の揺動軸21c回りの左 右方向の揺動によって移動し、ピン19を昇降させる。 溝23aの幅は、ローラ22の直径に対してわずかな隙 間を持たせているので、ガイド18とピン19とは下部 電極3の熱膨張にともなって移動できるという作用を有 する。また、レバー21の下端21a及びピン昇降シリ ンダ42のピストン42aの先端に一端が枢着された連 結棒24、レパー21及びピン19のポス23によっ て、他の3本のピン19とも連結されているため、ピン 昇降シリンダ42の駆動により、ピン19は4本同時に 昇降する。この4本のピン19を同時に昇降させる具体 的な構成例としては、図1のような2つのレバー21と その間を連結する連結棒24のセットがもう1組配置さ れ、かつ、2本の連結棒24が同時に同様に移動するよ うに図示しないレバーで連結されることにより、4本の ピン19を4個のレバー21の反時計方向の揺動により 同時に上昇させることができる。

【0012】上記構成によれば、ピン昇降シリンダ42 のピストンロッド 4 2 a が右方向に移動するように駆動 されるとき、4本のレバー21がそれぞれ揺動軸21c 回りに反時計方向に揺動し、4個のローラ22によりボ ス23を介して4本のピン19を同時に押し上げて、基 板10を下部電極3の表面から突き上げる。一方、ピン 昇降シリンダ42のピストンロッド42aが左方向に移 動するように駆動されるとき、4本のレバー21がそれ ぞれ揺動軸21c回りに時計方向に揺動し、4個のロー ラ22によりボス23を介して4本のピン19を同時に 押し下げて、基板10を下部電極3の表面に載置する。 ヒータ2の熱により、ピン19の昇降方向とは異なる方 向、例えば、昇降方向とは直交する方向に下部電極3が 熱膨張するとき、下部電極3に固定されたポス18と該 ボス18内を移動するピン19とが、下部電極3の熱膨 張に応じて、一体的に移動する。このとき、ピン19の 下端のポス23もピン19と一体的に移動するが、ボス 23の溝23a内のピン昇降シリンダ側に連結されたロ ーラ22は、溝23a内の内面を転動することにより、 ピン19の移動を妨げることがない。

[0013] なお、ピン19、下部電極3の昇降手段と 50 26, 29によって連結して使用するものである。

しては、シリンダの代わりに、モータを用いても同様の 効果が得られる。また、ピン19の本数は4本とした が、3本以上で基板サイズに応じた本数とする。なお、 50は下部電極3と電極昇降シリンダ16のピストンロ ッド16aの駆動板16bとを連結するロッド、51は 駆動板16bとチャンパ1との間に設けられチャンパ1 内と外部とを遮断するペローズであり、電極昇降シリン ダ16のピストンロッド16aの昇降駆動時において も、チャンパ1内の所定の真空度を維持できるように、 チャンバ1の内外をベローズ51で遮断している。

【0014】上記第1実施形態によれば、下部電極3の 裏面に複数のピン昇降ガイド18を設け、個々にピン1 9とピン穴20とピン昇降ガイド18を同心に設け、ピ ン19の下端のポス23の溝23a内に、ピン昇降手段 であるピン昇降シリンダ42のピストンロッド42aに 連結されたレバー21の右端ローラ22を嵌合して、ピ ン19とピン昇降手段との連結部においてピン19の昇 降方向のみを拘束するようにしている。よって、上記連 結部においては、ピン昇降手段によりピン昇降方向以外 の方向に拘束されていないので、ピン19とピン昇降ガ イド18とが下部電極3の熱膨張に伴い一体となって移 動できる。よって、髙温に加熱される下部電極3におい て、処理中に下部電極3上で基板10の裏面とピン19 とピン穴20で形成される隙間を最小にすることができ るとともに、下部電極3が熱膨張しても確実に動作し、 放電の回り込みを防止することができる。

【0015】また、上記第1実施形態において、電極昇 降シリンダ16とピン昇降シリンダ42とを同期制御す る制御装置100をさらに配置することもできる。この 場合、この制御装置100の同期制御により、電極昇降 シリンダ16の駆動により下部電極3が薄膜形成位置ま で上昇するとき、同時に、ピン昇降シリンダ42を駆動 してピン19も下部電極3とともに上昇して、ピン19 の先端と下部電極3の上面との間に大きなくぼみが形成 されないようにすることができる。このようにすること により、ピン穴内への放電の入り込む空間を常に小さく 保つことができ、ピン穴内への放電の回り込みを効果的 に防止することができる。

【0016】本発明の第2実施形態にかかる基板突き上 げ機構は、下部電極昇降手段によって、下部電極3の昇 降と基板10の突き上げピン19の昇降を同期させるも のであり、上記第1実施形態の作用効果に加えて、下部 電極3を昇降させても下部電極3の上面とピン19の先 端との隙間が変化しないようにするものである。図2に は、上記第2実施形態にかかる基板突き上げ機構を示 し、図3はその一部拡大図を示す。この第2実施形態で は、上記第1実施形態にかかる揺動リンク機構を利用し た基板突き上げ機構において、ピン昇降シリンダ42の 代わりに、下部電極3の電極昇降シリンダ16をレバー

【0017】この第2実施形態においては、チャンパ1 の下端に、ピストンロッド52aが下向きに移動するピ ン昇降シリンダ52が固定されており、このピストンロ ッド52aの下端にプッシャー25が固定されている。 このプッシャー25の左端にはローラ25aが回転可能 に備えられている。ローラ25 aは、プッシャー25の 下降に応じてレバー26の右端26aを上方から下向き に押し下げる。ローラ25aはレバー26の右端26a に上方から接触可能となっているだけで、ローラ25a が上昇するときにはローラ25aはレバー26の右端2 6 aから分離可能となっている。レバー26は、その中 間部が支点26 dにより回転可能に支持されている。こ のレバー26の中間部のやや左側の部分にバネ27の上 端が固定され、バネ27の下端はチャンバ1の設置床に 固定されており、パネ27の付勢力により、レバー26 はその支点26 d回りに、常時反時計方向に回転する方 向に付勢されている。レバー26の中間部の上部の二股 部26 bには、上記各ピン19に、ポス23及びローラ 22を介して連結されたレバー21の下端ピン21dが 相対的に回転可能に嵌合され、レバー26が時計方向に 20 回転するとレバー21が反時計方向に揺動される一方、 レバー26が反時計方向に回転するとレバー21が時計 方向に揺動されるようにしている。レバー26の左端2 6 c は、電極昇降シリンダ16のピストンロッド16 a に固定された駆動板16bの一端に下向きに突出固定さ れたレバー29の下端ローラ29aに当接可能となって いる。下端ローラ29 aはレバー26の左端26 cに下 側から上向きに当接可能となっているだけで、下端ロー ラ29aが下降するときにはレバー26の左端26cか ら分離可能となっている。

【0018】このような構成において、ピン19を上昇 させるときは、まず、ピン昇降シリンダ12の駆動によ りプッシャー25が図3において点線で示すように下降 し、プッシャー先端のローラ25aを介してレバー26 の右端26aを点線で示すように下向きに押す。この結 果、この下向きの押圧力は、レバー26に支点26d回 りの時計方向の回転を点線で示すように付与して、二股 部26bを介してレバー21の下端ピン21dをその揺 動軸21c回りに反時計方向に揺動させるような回転力 として伝達され、ローラ22及びポス23を介して、前 40 記したようにピン19を上昇させる。図3のような2つ のレバー21とその間を連結する連結棒24のセットが もう1組配置され、かつ、2本の連結棒24が同時に同 様に移動するように図示しないレバーで連結されること により、4本のピン19を4個のレバー21の反時計方 向の揺動により同時に上昇させる。よって、下部電極3 の上面に載置されていた基板10を4本のピン19で上 昇させる。

[0019] 一方、ピン昇降シリンダ52が逆に駆動されてプッシャー25が上昇して、プッシャー25のロー 50

ラ25 aがレバー26の右端26 aから離れると、バネ27の付勢力により、レパー26は支点26 d回りに反時計方向に回転し、二股部26 bを介してレバー21をその揺動軸21c回りに時計方向に揺動させる。このとき、4本のレバー21が連結棒24などにより同時に時計方向に揺動されるため、4本のピン19は同時に下降する。

【0020】また、電極昇降シリンダ16の駆動によりそのピストンロッド16aを上昇させて下部電極3を上昇させると、電極昇降シリンダ16のピストンロッド16aの上昇動作に伴い、レバー29も上昇し、レバー29の下端ローラ29aがレバー26の左端26cを上向きに押し上げてレバー26がその支点26d回りに時計方向に回転する。よって、上記ピン昇降シリンダ52のプッシャー25のローラ25aによりレバー26の右端26aが押し下げられたときと同様にレバー26が時計方向に回転させられるため、4本のピン19が同時に上昇させられる。この結果、下部電極3の上昇動作に伴い4本のピン19が同時に上昇することができる。

【0021】一方、電極昇降シリンダ16の逆駆動により、下部電極3が下降すると、バネ27の作用によりレバー26が反時計方向に回転して各レバー21が時計方向に揺動するため、4本のピン19も下部電極3の動作にともない同期して下降する。これにより、下部電極3を昇降させても4本のピン19が同期して昇降させることができ、各ピン19の先端と下部電極3の上面との位置関係が昇降動作に拘わらず変わらないという作用を有する。このように位置関係が変わらない結果として、下部電極が薄膜形成位置に位置しても、ピン19の先端と下部電極3の上面との間に大きなくぼみが形成されないようにすることができる。このようにすることにより、ピン穴内への放電の入り込む空間を常に小さく保つことができ、ピン穴内への放電の回り込みを効果的に防止することができる。

【0022】なお、上記ではピン19の昇降機構と下部電極3の駆動機構を同期するよう機械的に連結したが、ピン19の昇降機構と下部電極3の駆動機構をそれぞれ独立に制御し、同期させても同様の効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1実施形態において、揺動リンク を用いた基板突き上げ機構を示す概略説明図である。

【図2】 本発明の第2実施形態において、ピンと電極の昇降を同期させた基板突き上げ機構を示す概略説明図である。

【図3】 図2の一部拡大図である。

【図4】 従来の基板突き上げ機構の概略説明図である

【符号の説明】

1 チャンバ

50 2 ヒータ

9

- 3 下部電極
- 4 上部電極
- 17 取付フランジ
- 18 ガイド
- 19 ピン
- 20 ピン穴

21, 26, 29 レパー

22, 25a, 29a ローラ

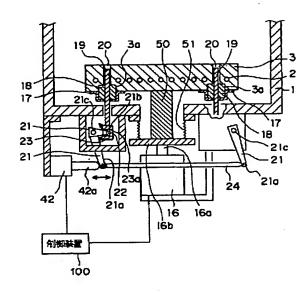
23 ポス

24 連結棒

25 プッシャー

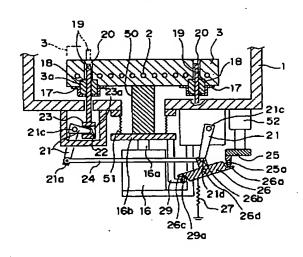
27 パネ

【図1】

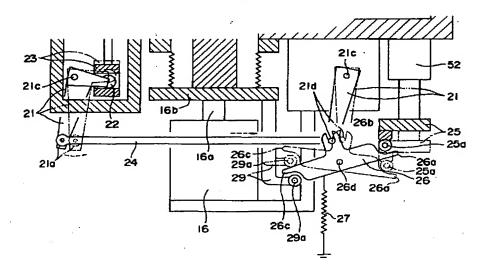


【図2】

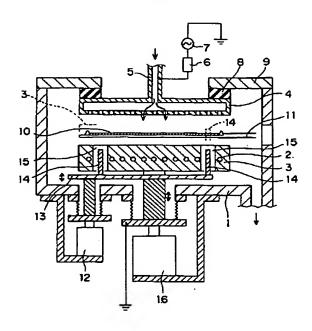
10



[図3]



【図4】



## フロントページの続き

(51) Int. Cl. 4

識別記号

FΙ

H01L 21/68

H 0 1 L 21/205 ·

// H 0 1 L 21/205

21/302

В

(72)発明者 田辺 浩

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内